

合肥晶合集成电路股份有限公司

关于刊发 H 股发行聆讯后资料集的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

2025 年 9 月 29 日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。按照本次发行上市的时间安排并根据香港联交所的相关规定，公司于 2026 年 3 月 31 日重新向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。具体内容详见公司分别于 2025 年 9 月 30 日、2026 年 4 月 2 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于向香港联交所递交 H 股发行上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-062）、《晶合集成关于重新向香港联交所递交 H 股发行上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2026-008）。

2026 年 5 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于合肥晶合集成电路股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1134 号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 23 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于发行境外上市股份（H 股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2026-014）。

2026 年 6 月 4 日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请。

根据本次发行上市的时间安排，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本

次发行聆讯后资料集，该聆讯后资料集为公司根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的要求而刊发，刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合格的投资者。同时，该聆讯后资料集为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。

鉴于聆讯后资料集的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该聆讯后资料集，但为使境内投资者及时了解该聆讯后资料集披露的本次发行上市及公司的其他相关信息，现提供该聆讯后资料集在香港联交所网站的查询链接：

中文：

<https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108380/documents/sehk26060801171.pdf>

英文：

<https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108380/documents/sehk26060801172.pdf>

需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的聆讯后资料集均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。

公司本次发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的批准或核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2026年6月9日